

# 电子制造与封装



[电子制造与封装 下载链接1](#)

著者:杜中一 编

出版者:

出版时间:2010-3

装帧:

isbn:9787121104602

《电子制造与封装》系统地介绍了电子产品的主要制造技术。内容包括电子制造技术概

述、集成电路基础、集成电路制造技术、元器件封装工艺流程、元器件封装形式及材料、光电器件制造与封装、太阳能光伏技术、印制电路板技术以及电子组装技术。书中简要介绍了电子制造的基本理论基础，重点介绍了半导体制造工艺、电子封装与组装技术、光电技术及器件的制造与封装，系统介绍了相关制造工艺、相关材料及应用等。

《电子制造与封装》针对高职高专的学生特点，以实用为主，够用为度为原则，系统地介绍了电子制造与封装。《电子制造与封装》可作为微电子、电子制造、半导体、计算机与通信、光电、电子等相关专业高职高专的教材，也可作为相关专业学生的自学参考书籍使用。

作者介绍:

目录:

[电子制造与封装\\_下载链接1](#)

标签

评论

-----  
[电子制造与封装\\_下载链接1](#)

书评

-----  
[电子制造与封装\\_下载链接1](#)